

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2023-015

成都硅宝科技股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月24日召开公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容如下：

一、申请综合授信额度情况概述

为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及全资子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地使用权、设备等）提供抵押担保及子公司互保等方式向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币80,000万元，期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。

上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。

为便于董事会在其权限范围内办理上述银行授信（包括但不限于银行综合授信）以及授信项下相应具体信贷事宜，在满足上述授信用途、授信额度及担保方式的条件下，授权公司经营管理层具体办理公司及子公司向银行申请授信或借款等相关事宜，包括但不限于：

1、根据公司经营的实际情况，在满足上述授信用途、授信额度及担保条件

范围内，确定借款金额、借款期限、借款利率、担保方式等事项；

2、履行公司向银行申请授信或借款等事宜有关的相关程序，包括但不限于签署向银行申请授信或借款等过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件等，办理与担保相关的他项权利登记手续等；

3、全权办理向银行申请授信或借款等有关的其他事宜。

二、对公司的影响

本次向银行等金融机构申请综合授信是为了满足公司及子公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2023年03月25日